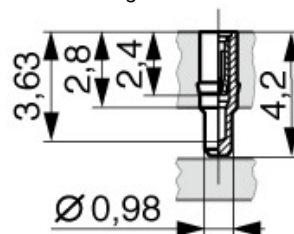




| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) | ∅ 0,40-0,56 □ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 28 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | ⬇ SMD Floating |
| Ausrichtung zu PCB | ⬆ Vertikal |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 300 mil |
| Kontakttyp | SMD Floating |



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Veredelung Kontaktfeder | Au |
| Reihenabstand (mm) | 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Beryllium Kupfer |
| Sockellayout | ⚡ DIL (Dual-in-line) |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Stange |
| A | 35,50 |
| B | 10,10 |
| C | 4,40 |

